

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	人保基金、新华基金、大摩基金、工银理财、建信保险、中邮人寿保险、太平洋资产、长城财富保险资产、和谐汇一、汇添富、中荷人寿保险、泰信基金、民生加银基金、招银理财、华安基金、华富基金、诺安基金、长城证券、德邦基金、西部利得基金、诺德基金、源峰基金、太平基金、瑞达基金、博时基金、安信证券、中信建投、招商证券、华安证券共 29 家机构。
时间	2022 年 11 月 23 日-12 月 23 日
地点	公司会议室
形式	电话会议
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李莉莉
交流内容及具体问答记录	一、公司概述 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。

二、问答环节

1、公司三季度报告中研发费用增加明显，是否受到了企业人员数量增加的影响？

是的，公司人员数量的快速增长对研发费用的增加影响较大。2021年底，公司人员总数为169人，截至9月末的人员总数近300人。在人员结构上，公司基本保持约70%的人员是研发人员，生产人员合并计算后占比80%以上。未来，随着公司在EDA软件、测试设备硬件等方面产品和技术的进一步横向拓展研发，公司客户群体及销售订单的不断增长，公司的人员团队将进一步扩大规模。

2、公司EDA软件的竞争优势有哪些？

首先，公司的EDA软件是成品率提升全流程中重要的组成部分，可以单独销售实现其产品价值，也可以和公司其他产品共同销售构成一站式的成品率解决方案；其次，公司的EDA软件产品经过十多年的打磨，贴近集成电路制造工艺，在多个工艺节点上都实现了成功验证，具备系统化的设计流程和成熟的模块化功能，这对于制造类EDA产品是非常重要的；第三，公司的EDA软件采取自主研发的模式，在可寻址测试芯片、超高密度技术、片上测试加速等多个关键技术已经达到业界领先水平，在成品率提升领域具备核心竞争力；第四，在商业模式上，公司提供软件工具授权与软件技术开发相结合的灵活商业模式，满足客户在成品率提升与保密性等多方面的需求，符合集成电路的产业发展趋势。

3、公司的WAT测试设备在研发上有哪些进展？

公司的WAT测试设备自在国内典型晶圆厂验证成功后，公司综合考虑人力资源及客户需求，选择高速并行测试机作为主力机型进行推广并取得了客户的广泛好评，设备销量逐年快速增长。与此同时，公司并没有停止产品优化和创新的脚步。一方面，公司致力于通用型WAT测试设备的架构改进，不断提高设备性价比，现已基本完成该款设备的升级优化，后期将以此机型进一步开拓成熟工艺的6/8寸晶圆厂；另一方面，基于半导体测试场景对电性测试的多源化需

求，公司正在进行可靠性测试设备的开发并取得了初步成果，预计后期随着产品的成功研发，将进一步丰富公司晶圆级电性测试设备的产品线，为公司的业务发展贡献业绩。

4、公司在数据软件端已经发布数款软件，目前该方向上的市场进展情况如何？

公司已经推出的数据产品包括通用化分析工具 DE-G、集成电路良率分析与管理系统 DE-YMS、集成电路缺陷管理系统 DE-DMS，这三款软件自产品立项起，广立微即开始与下游典型客户进行协同，并将公司十多年对数据的理解和分析经验整合到产品模块中，立足于开发出半导体业界高质量的数据分析软件，解决定制化与灵活性难以两全的关键技术问题。为了更好地彰显出前述数据分析软件产品的功能特点和产品优势，公司采用先试用后购买的模式进行推广，截至目前，公司的数据分析软件已经在集成电路设计、制造及封测厂商等不同类型的多家企业进行试用并得到高度认可，部分试用客户与公司就软件采购已进行到商务落地阶段。

5、请公司对明年的整体发展做简要介绍。

首先，在技术开发上，公司将不断加大研发投入力度，从 EDA 设计软件、数据分析软件、电性测试设备三个方面吸纳优秀人才，一方面，不断横向扩展产品生态矩阵，如可制造性 EDA 软件、可靠性测试设备、离线数据软件迭代优化和部分在线数据模块等产品和技术的开发；另一方面，纵向优化产品的技术深度，强化公司在成品率提升领域的技术优势，铸就更高的技术壁垒，提高企业的核心竞争优势，助力公司未来的业务形成更系统化的产品和市场生态。其次，在业务推广上，目前集成电路产业在人工智能、5G、汽车电子等领域的驱动下仍然在不断发展，加之国内晶圆厂的持续扩建、软硬件产品的国产替代需求加大等因素，使公司的产品和技术有更多的市场机遇；同时，基于公司前期产品和技术的生态布局，以及今年研发推出的新产品，使公司软、硬件一体化解决方案更为全面，业务市场空间不断扩大；公司将持续加强业务推广力度，充分发挥公司

	软、硬件产品件的相互促进、协同引流的优势，利用一流的技术、高质量的产品深入服务老客户，同时不断拓展开发从设计、制造到封测端的新客户，助力公司业务稳定快速增长。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2022年12月23日